超强适应性

BRS-7500

- 采用 PCB 外形或定位孔定位。任何 PCB 都可处理。
- X,Y 方向移动式和整体独特设计，使得设备空间得到充分利用，以相对较小的设备体积实现超大面积 PCB 返修，可处理最大尺寸 630*610mm，无返修死角
- 对应元器件范围广， QFP,SOIC,BGA,PBGA,CSP 均可处理；可返修最大 BGA 尺寸 70*70mm；

超精温度控制

- 上部热风，下部为热风+IR.。升温快，升温速率可达 10℃/s；冷却快，可实现温度突降 50-80℃；大功率加热系统可保持温度均匀，更好的满足无铅焊接的工艺要求。
- 独立三温区（上温区、下温区、底部 IR 预热区），上温区和下温区实现同步移动，可手动达到底部红外预热区内的任意位置。下温区可上下运动，支撑 PCB,采用电机自动控制。可实现 PCB 在夹具上不动，上下加热头可一体移动到 PCB 上的目标位置。
- 独创的底部预热平台，采用德国进口优良的发热材料（镀金 IR 管） +防炫恒温玻璃（耐温达 1800°C），预热面积达 500*420 mm。
- 不同于以往的 Switching Control： BRS-7500 采用 Analog Control（即通过模拟量连续控制发热体的功率，从 0-100%连续可调，来达到稳定精准的温度控制），目前高端回流焊均采用此加热控制方式；嵌入式工控电脑，触摸屏人机界面。
- 10 段升温/降温+10 段恒温控制，可海量存储温度曲线， PLC 控制，实时温度曲线显示，可显示设定

曲线和实测曲线，在触摸屏上即可对温度曲线进行比对分析。

超级智能化

- 吸嘴自动识别吸料和贴装高度，压力可控制在 10 克微小范围内，具有 0 压力吸料、贴装功能，针对较小芯片；同时喷嘴中途具有保护撞击功能，软件内部具有下降防压功能；
- 彩色高清光学视觉系统,具手动 X,Y 方向移动，具分光双色、放大和微调功能，含色差分辨装置，自动对焦、软件操作功能， 22 倍光学变焦，光学放大 220 倍数码变焦，
- BRS-7500 可自动生成 REFLOW 温度曲线，无需人工设置，有无经验操作者均能使用，实现温度控制智能化。
- 采用带有定位刻度的治具上完成自动取或拆放芯片，只要在操作屏上输入芯片大小，上部风头会自动吸取芯片中心位置，更加适合批量生产
- 吸嘴角度 360°旋转，由步进电机控制，可自动记忆旋转角度，光学对位由遥控电机操控，带自动记忆吸料、放料、对位功能，有自动观察芯片四角功能

超高集成度

- 热风头和贴装头一体化设计，具有自动焊接和自动拆卸功能；；
- 内置真空泵，Φ角度 360°旋转，精密微调贴装吸嘴；
- 多种尺寸合金热风喷咀，易于更换，可 360°旋转定位。
- 配置 5 个测温端口，具有多点实时温度监测与分析功能。
- 配备氮气接入口，可外接氮气保护焊接，提高返修后焊接质量。

规格参数

型号：	BRS-7500
最大 PCB 尺寸：	W630*D610mm
PCB 厚度：	0.5~5mm
适用 BGA 尺寸：	1*1~70*70mm
适用芯片最小间距：	0.15mm
贴装最大荷重：	500g
贴装精度：	±0.01mm
PCB 定位方式：	外形或定位孔
温度控制方式：	K 型热电偶、闭环控制
下部热风加热：	热风 800W
上部热风加热：	热风 1200W
底部预热：	红外 6000W
使用电源：	3 相 380V、 50/60Hz
机器尺寸：	W970*D700*H830mm(不含支架)
机器重量：	约 130KG